

长鑫科技站上全新发展平台



本报记者 许子皓

5月27日，记者从上海证券交易所官网获悉，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）已通过上市委员会，距离成功上市更进一步。

据了解，长鑫科技此次IPO拟募资的295亿元若顺利实施，将成为科创板开板以来拟募资规模最大的IPO项目，但从实际募资口径看，目前科创板募资规模历史第一大为中芯国际2020年上市的532.3亿元。

业绩亮眼

公司进入盈利新阶段

长鑫科技主营DRAM动态随机存取存储器的研发、生产与销售，产品广泛应用于服务器、消费电子、车载电子、工业设备等多个领域，经营走势与全球存储行业周期、下游AI算力需求高度绑定。此前受行业下行周期影响，公司连续多年处于亏损状态，随着2025年下半年全球存储市场回暖，DRAM产品价格持续上行，叠加AI服务器、高性能计算设备需求爆发，公司产能稳步释放，经营基本面实现实质性反转。

从最新财务数据来看，长鑫科技的IPO招股书中显示，2023年至2025年，企业营收规模逐年攀升，成功扭转持续亏损态势，实现扭亏为盈。进入2026年，行业景气度持续延续，公司业绩迎来集中爆发，第一季度营业收入达508亿元，同比增长719.13%，净利润330.12亿元，同比增长1268.45%，盈利效率大幅提升。根据企业半年度业绩预告，2026年上半年营收将达1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%，归母净利润区间为500亿元至570亿元，进入稳定盈利的经营新阶段。

本轮业绩增长核心依托两大优势，一是下游市场需求扩容，AI产业快速发展带动高端存储芯片需求激增，DDR5、LPDDR5等高端DRAM产品市场订单充足；二是公司产品结构持续优化，高端产品营收占比不断提升，叠加产能稳步爬坡，规模效应持续凸显。需要明确的是，存储行业具备极强的周

期性，供需关系波动、产品价格涨跌都会直接影响企业盈利水平，周期波动仍是公司后续经营面临的核心不确定性因素。

市场方面，根据招股书，长鑫科技目前与阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo等行业核心客户开展了深度合作，市场份额进一步提升；基于Omdia数据测算，按2025年第四季度DRAM销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

百亿级募资

聚焦产能技术补短板

据了解，长鑫科技此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术与开发项目等核心主业项目。本次295亿元的拟募资规模，创下科创板开板以来拟募资项目新高，超越中芯国际2020年IPO时约200亿元的计划募资规模。

长鑫科技本次募资资金全部聚焦主营业务发展，在产能端，资金将重点用于现有晶圆制造产线的升级改造，优化生产工艺，提升产能利用率，进一步扩大主流DRAM产品量产规模，匹配当前下游市场的增量需求，持续发挥规模成本优势。在技术端，资金将用于攻坚先进制程，跟进HBM高带宽内存等行业前沿高端产品研发，缩小与国际头部存储企业的技术代差，补齐高端产品

布局短板。同时，企业将依托募投资金开展下一代存储技术预研，为长期技术迭代和产品升级储备核心能力。

股权结构层面，长鑫科技由地方国资主导，股东阵容涵盖多家国有金融机构与产业资本，股权架构稳定，可长期为产能扩建、技术攻关提供保障。伴随本次募资落地，企业重资产运营下的资金压力将得到显著缓解，有助于产线升级、技术突破稳步推进，持续增强综合竞争力。

资本赋能打开成长空间

多重挑战仍需应对

随着AI、高性能计算、智能汽车等产业快速发展，高端存储芯片需求持续扩容，为存储企业发展提供了良好的行业环境。本次顺利过会，将为长鑫科技带来全新的发展契机，借助资本市场平台，公司可进一步完善治理结构、拓宽融资渠道、提升品牌影响力。依托资本赋能，公司后续将持续推进产能扩张与技术升级，稳步提升产品市场占有率，持续完善自身综合实力。

从国内产业层面来看，长鑫科技的资本化发展，进一步完善了国内存储芯片产业布局，填补了本土通用DRAM商业化量产的产业环节，能够带动上下游设备、材料、封装测试等配套产业协同发展，助力国内半导体产业链持续成熟。在A股市场层面，长鑫科技过会会成为半导体板块的正向行业事件，有效提振硬科技板块市场情绪。公司未来挂牌上市后，将进一步丰富科创板科技企业阵容，完善存储赛道权

重布局，为科技板块注入新的活力。本次过会是长鑫科技发展历程中的重要阶段性成果，资本赋能之下，企业长期成长空间进一步打开，产业价值有望持续释放。

但业内专家也表示，长鑫科技在快速发展过程中，仍面临行业、经营、技术等多维度现实挑战与风险。一是行业周期波动风险，DRAM行业供需格局波动剧烈特征显著，当前公司业绩高增主要依托行业上行周期与产品溢价红利，若未来AI需求不及预期、全球供需格局逆转，行业进入下行周期，公司产品价格和盈利水平或将出现明显波动；二是经营财务压力，存储芯片属于重资产行业，前期持续大额投入导致公司仍存在较大累计未弥补亏损，叠加长期借款规模较高，持续扩产和高强度研发仍将长期占用企业现金流，对后续精细化运营和资金管控提出较高要求；三是行业技术竞争挑战，国际头部厂商持续加码先进制程、HBM高端存储产能与技术研发，持续巩固技术和产能壁垒，行业技术迭代速度快，竞争门槛持续抬升，公司后续技术追赶、高端产品市场化落地仍面临一定压力，需要长期稳定的研发投入与技术积累持续突破。

值得关注的是，长鑫科技董事长朱一明同时为兆易创新实控人、董事长，5月26日晚间兆易创新披露，朱一明在5月11日至5月25日期间通过集中竞价与大宗交易累计减持公司股份0.90%，其与一致行动人合计持股比例由7.90%降至7.00%，权益变动触及1%披露线，此次减持发生在长鑫科技IPO会上前夕，引发市场关注。

戴尔AI服务器积压订单创纪录 达513亿美元

本报讯 近日，在AI基础设施需求持续爆发的推动下，戴尔公司2027财年第一财季（截至2026年5月1日）营收、利润双双超预期，同时大幅上调全年业绩指引。

财报数据显示，2027财年第一财季，戴尔总营收达到438.4亿美元，同比增长近88%创下历史新高。这也是戴尔自2018年重返公开市场以来创下的最快单季营收增速。戴尔2027财年第一财季获利表现亮眼。GAAP口径下，戴尔净利润达到34.38亿美元，较上年同期的9.65亿美元同比增长256.48%；GAAP稀释每股收益为5.24美元，同比增长282%，创历史新高；GAAP毛利率为17.8%，较上年同期的21.1%下降3.3个百分点。

戴尔首席财务官大卫·肯尼迪（David Kennedy）在财报电话会中解释称，Non-GAAP毛利率下滑至

18.1%，主要受AI服务器产品组合向更低毛利率的AI服务器倾斜所驱动，第一财季AI服务器收入同比增长近9倍，这类产品通常毛利率较低，结构性拉低了整体毛利率水平。此外，戴尔AI服务器收入同比暴涨757%，达到了161亿美元。

从具体业务表现来看，戴尔第一财季最大的增长引擎无疑是AI服务器业务。由于搭载英伟达等厂商GPU的服务器需求持续旺盛，戴尔AI服务器收入同比暴涨757%，达到了161亿美元。

从订单数据来看，AI需求也呈现出异常强劲且多元的态势。据戴尔首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）透露，戴尔当季斩获了244亿美元的AI相关订单，客户数量已突破5000家，涵盖大型云服务租赁

商、主权实体和传统企业。截至第一财季末，戴尔的AI服务器积压订单达到了创纪录的513亿美元，并且储备项目的金额更是数倍于这一数字。

Jeff Clarke在声明中直言：“AI的机会丝毫没有放缓的迹象。”

面对如此汹涌的需求，戴尔将2027财年全年的AI服务器收入预期从今年2月给出的500亿美元大幅上调至600亿美元，隐含约144%的同比增长。

值得关注的是，不仅AI服务器供不应求，戴尔的传统服务器和PC业务也表现强劲。

财报显示，包含服务器、网络 and 存储的基础设施解决方案集团（ISG）第一财季的总营收也暴涨了181%，达到创纪录的290亿美元。其中，传统服务器和网络收入同比增长92%至85亿美元。

Jeff Clarke解释称，企业在部署AI推理和“智能体工作负载”时，需要更多CPU来协同GPU完成输入输出和内存管理等工作，这为传统计算创造了增量需求。

包含商业和消费PC的客户端解决方案集团（CSG）第一财季营收同比增长17%，达到146亿美元。其中，面向企业的商用PC收入增长18%，延续了第七个季度的增长势头。

Jeff Clarke预计，目前全球约1/3的PC机龄已达四年以上，这将持续支撑企业换机需求。

基于第一季度的强劲表现和对未来需求的乐观预期，戴尔同步上调了2027财年全年展望。全年营收预期从此前的1380亿美元至1420亿美元上调至1650亿美元至1690亿美元，第二财季预计营收为440亿美元至450亿美元。（姬晓婷）

比亚迪发布中国首款4nm智驾芯片

本报讯 记者许子皓报道：2026年5月28日，比亚迪召开“敢为”智能化战略发布会，推出中国首款4nm制程智驾芯片——璇玑A3。比亚迪董事长王传福在会上表示：“电动化上半场看电池，智能化下半场看芯片。”

据了解，璇玑A3已开启规模化量产，支持L3、L4自动驾驶，通过三颗芯片的高效协同，实现超2100 TOPS的总算力，同时兼顾功耗控制与算力利用率，单位算力功耗较同级产品低20%。璇玑A3可结合比亚迪自研算法，实现深度优化，将算力利用率提升100%，让辅助驾驶的反应更快，处理复杂问题的能力更强，安全上限更高。

过去几年，全球迎来新一轮人工智能发展浪潮，感知硬件、芯片的发展速度超乎想象，这些推动着汽车从单纯的出行工具进化为能主动思考的智能生命体。从人的真实需求出发，比亚迪为汽车智能化的下半场设定了三大目标：实现“零交通事故”，让辅助驾驶成为“超级司机”，让AI成为“超级秘书”。比亚迪将持续投入超1000亿元的研发资金，解决交通安全问题。

二十四年来，比亚迪持续布局

芯片领域，先后做到车规级IGBT和SiC功率芯片技术国内最早量产装车，至今，比亚迪已推出2000多款芯片产品，应用在智能汽车、消费电子、家用电器、工业设备、光伏储能五大领域。在认证标准严苛的车规级领域，比亚迪已拥有567款芯片产品，广泛应用于46个国内外汽车品牌。

此外，比亚迪的天神之眼辅助驾驶系统也迎来四大升级：架构方面，升级为璇玑架构2.0，搭载舱驾电三合一的中央大脑；传感器方面，行业首创卫星架构；算法方面，升级为物理AI大模型；数据方面，基于比亚迪行业最大的数据底座，海量的数据可被用透、用活，发挥最大价值，让智驾模型快速迭代。

比亚迪表示，旗下全系车型均可搭载天神之眼B辅助驾驶激光版，选装价格12000元。天神之眼C的功能即将迎来升级，预计今年12月OTA（远程升级）。

未来，比亚迪将推出天神之眼自动驾驶版（L3/L4），不仅有平台架构的十重冗余，而且全球首搭超千线激光雷达、闪拍摄像头、双远红外摄像头，提升自动驾驶的安全系数和体验感。

北方华创首台面板级封装去胶设备出厂

本报讯 近日，北方华创宣布，其首台600mm×600mm面板级封装去胶设备（Descum）成功出厂，标志着这家本土半导体设备龙头在面板级封装领域再进一步，为我国先进封装产业升级注入新动能。

在半导体制造流程中，Descum工艺是影响产品良率与生产效率的关键环节。面对不同材料、膜层、图形结构带来的多样化去胶需求，北方华创表示，公司坚持“一客一方”的定制化开发理念，将解决客户实际需求作为产品开发的核心导向。

此次出厂的面板级封装去胶设备是北方华创与客户携手开展技术合作的重要成果，标志着公司在大幅曲度基板低温去胶、大面积刻蚀均匀性等核心关键技术上取得实质性突破。针对600mm×600mm大尺寸基板，设备的刻蚀均匀性、基座表面温度均匀性均满足业内主流需求。

在技术参数方面，针对PI、PR、ABF等高温敏感材料，面板级封装去胶设备搭载主动降温系统，可将基板温度稳定控制在75℃以内，大幅提升良品率。设备还基于动态电极间距调节技术，可根据不同材料的工艺需求实时优化等离子体分布状态，不仅让大板面上的去胶效果高度均匀一致，同时显著缩短单批

工艺时间，提高单位产出。

随着AI芯片等需求持续爆发，传统晶圆级封装的面积利用率和成本效益面临挑战。面板级封装凭借更高的面积利用率和单位产出，正成为行业重点布局的方向。

北方华创在晶圆级封装领域已积累了深厚的技术基础，此次成功推出面板级封装设备，正是依托这一技术积淀的延伸与拓展。

目前，北方华创在刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法清洗、离子注入、涂胶显影、键合等多个领域均有布局。其中，2025年刻蚀设备收入已超过100亿元，薄膜沉积设备收入同样超过100亿元。

2025年北方华创还通过取得芯源微控制权（合计持股17.87%），成功切入涂胶显影领域，产品矩阵进一步完善，湿法全流程工艺覆盖度超过97%。

在先进封装设备方面，北方华创于2026年3月正式发布了12英寸晶圆对晶圆混合键合设备，12英寸芯片对晶圆混合键合设备，成为国内率先完成D2W混合键合设备客户端工艺验证的厂商。

此次北方华创面板级封装Descum设备的成功出厂，更加丰富了其在封装领域的产品。（幸 稳）

三星开始供货12层HBM4E样品 运行速度提升超过20%

本报讯 近日，三星电子宣布首次向全球客户提供最新一代高频宽内存——12层堆叠的HBM4E样品，该芯片将成为下一代人工智能加速器的核心，将有望巩固其在HBM市场的领先地位。

据介绍，三星电子的HBM4E采用了基于前代HBM4中已验证的最先进工艺的1c(10nm级第六代)DRAM和其自有工厂的4nm逻辑芯片。经评估，它通过最大限度地提高超精细工艺的稳定性，同时确保良率和大规模生产能力，建立了竞争对手难以企及的压倒性准入壁垒。

在存储性能方面，该HBM4E通过设计和工艺优化，实现了无与伦比的规格。它支持每引脚14Gb-1ps至最高16Gbps的运行速度，与上一代HBM4相比，速度提升超过20%。此外，它以单个堆栈为单位提供每秒3.6TB（大字节）的带宽，最大限度地提高了大规模语言模型（LLM）和下一代AI系统的计算速度。

在容量方面，HBM4E 12层产品实现了48GB（千兆字节）的高容量，比上一代产品提升了30%以上。三星电子正在计划无缝扩展产

品线，推出32GB（8层）和64GB（16层）产品，以满足客户多样化的业务环境需求。

此外，通过集成低功耗设计和封装结构优化技术，与之前的型号相比，HBM4E的能源效率显著提高了16%，热阻提高了14%以上。彻底解决高负载人工智能计算环境中的关键发热问题，它保证了产品的长期可靠性，并有效地为降低全球数据中心的能耗提供了突破性的解决方案。

三星电子计划以此次HBM4E样品供应为起点，按照客户的进度安排进行批量生产。三星电子计划凭借全球唯一的“一站式交钥匙解决方案”（涵盖存储器、晶圆代工、系统LSI和先进封装），确保无缺陷的稳定供应。

与此同时，三星电子也在扩大HBM4的量产供应，HBM4是世界上第一款量产并于今年2月出货的芯片。三星电子表示，全球客户对三星HBM4的速度和能效给予了积极评价。去年12月，三星电子的HBM4在系统级封装（SiP）测试（最终认证阶段）中展现了业界领先的11.7Gb-1ps速度，获得了最高评级。

（文 轩）